



Produktliste Bleifrei-Lotpaste in Dosen von Koki

Koki ist weltweit bekannt für seine technische Unterstützung, Produktentwicklung und Lieferketten-Organisation. Seit der Gründung 1964 werden High-Tech-Produkte für die Lötindustrie hergestellt. Koki entwickelt laufend neue Technologien, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Die folgenden Standardlegierungen von bleifreier Lotpaste repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte die von Ihnen benötigte Legierung nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

S3X58-M406 Bleifrei-Lotpaste No-clean

Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-Fine-Pitch (<0,4 mm Pitch) und Mikrokomponenten (<0,25 mm Ø CSP, 0603 Chip) und ermöglicht eine lange Schablonenruhezeit. Perfekte Schmelz- und Benetzung bei Super Fine-Pitch und Mikrokomponenten (<0,25 mm Ø CSP, 0603 Chip). Das speziell entwickelte Flussmittel gewährleistet extremes low voiding mit CSPs und breite Kontaktflächen-Komponenten.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2963	S3X58-M406	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 218°C

S3X48-M406-3 Bleifrei-Lotpaste No-clean mit Anti-Kissen-Effekt

S3X58-M406-3

Verhindert das Auftreten von versteckten Kisseneffekten und sichert die Qualität der Lötstellen. Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-Fine-Pitch und CSP-Anwendungen und ermöglicht eine lange Schablonenruhezeit. Mit der neuen hitzebeständigen Flussmittelformel gelingt die vollständige Lotschmelze und Benetzung der Mikrokomponenten. Es ermöglicht eine einheitliche langfristige Bedruckbarkeit durch die Verhinderung des Viskositätsabfalls. **Viskosität (Pa.S) 210 ± 10%.**

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2961	S3X48-M406-3	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	3	ROLO	500 g	217° - 218°C
2964	S3X58-M406-3	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 218°C

S3X58-M406L Bleifrei-Lotpaste No-clean mit Anti-Kissen-Effekt

Verhindert das Auftreten von versteckten Kisseneffekten und sichert die Qualität der Lötstellen. Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-Fine-Pitch und CSP-Anwendungen und ermöglicht eine lange Schablonenruhezeit. Mit der neuen hitzebeständigen Flussmittelformel gelingt die vollständige Lotschmelze und Benetzung der Mikrokomponenten. Es ermöglicht eine einheitliche langfristige Bedruckbarkeit durch die Verhinderung des Viskositätsabfalls. **Viskosität (Pa.S) 170 ± 10%.**

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2019	S3X58-M406 L	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 218°C



S3X58-M406D Bleifrei-Lotpaste No-clean für allgemeine Dosiersysteme

Für allgemeine Dosiersysteme. Diese Lotpaste besteht aus einer Kombination von binären eutektischen Legierungen aus Zinn und Silber, welche halogenfrei ist. Das No-clean-Flussmittel ermöglicht eine Lötleistung und Benetzbarkeit, welche herkömmlichen No-clean-Lotpasten entspricht. Die Sorgfältig ausgewählte Flussmittelchemie sorgt für einzigartig niedrige Hohlräume und eine leistungsfähige Lot-Benetzung. Es hat eine extrem hohe Zuverlässigkeit. Die extrem lange Klebrigkeit bietet ein breites Verarbeitungsfenster. Die Flussmittelrückstände sind farblich unauffällig, was eine überlegene optische Erscheinung bietet.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2960	S3X58-M406 D	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 218°C

S3X70-M500C Bleifrei-Lotpaste No-clean für superfeine Muster und Mikrokomponenten

Das verwendete Hochtemperatur beständige Flussmittel gewährleistet eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit und bietet robuste Benetzungseigenschaften für 0402 Chip-Bauteile, auch ohne Verwendung von Stickstoff. Sichert hohe Verarbeitbarkeit und Leistung in Bereichen wie Haftvermögen, Wärmerückgang und Voiding. Herausragende Druckbarkeit von superfeinen Mustern (0.4mm pitch QFP, 0.5mm pitch CSP, 0402-Chip).

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2990	S3X70-M500C	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	5	ROLO	500 g	217° - 218°C

S3X48-M420 Bleifrei-Lotpaste No-clean für die Anwendung in Druckschablonen

S3X58-M420

Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-fine-pitch (0.4mm/16mil) und CSP Anwendungen (>0.3mm dia.) für normales bis schnelles Drucken und einer langen Schablonenleerlaufzeit. Ist bedienerfreundlich und bietet ein sehr breites Verarbeitungsfenster. Sichert gleichbleibende Qualität und Leistung bei Dauereinsatz über mehrere Tage. Sehr sparsam in der Anwendung. Halogenfrei (Br ≤ 900 ppm, Cl ≤ 900 ppm, Br + Cl ≤ 1500 ppm).

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2967	S3X48-M420	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	3	ROLO	500 g	217° - 219°C
2966	S3X58-M420	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 219°C

S3X48-M500 Bleifrei-Lotpaste No-clean für die Anwendung in Druckschablonen

S3X58-M500

Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine drastische Reduktion des Voidings bei Komponenten mit grosser Kontaktfläche zu erzielen, wie z. B. bei Leistungstransistoren, QFN und vor allem bei automatisierten Anwendungen. Anti-Kisseneffekt-Formel. Kraftvolle Benetzung. Sichert gleichbleibende Qualität und Leistung bei Dauereinsatz über mehrere Tage. Sehr sparsam in der Anwendung. Halogenfrei. Die Lotpaste ist geeignet für superfeine Muster, MBGA, 0.4mmP QFP, QFN.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2975	S3X48-M500	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	3	ROLO	500 g	217° - 219°C
2976	S3X58-M500	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 219°C
2976/250	S3X58-M500	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	250 g	217° - 219°C



S3X48-M500C-5 Bleifrei-Lotpaste No-clean für Leistungsstarke Benetzung + Anti-Kisseneffekt

S3X58-M500C-5

Im heutigen SMT-Bereich haben sich die Anwendungsbereiche und Arten der Leiterplatten erhöht. Die Lötbedingungen werden den verschiedenen Oberflächen und der Qualität des Basismetalls angepasst. Oxidierte Komponenten sind als Verursacher vieler Lötfehler ein großes Problem.

Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-fine-pitch (0.4mm/16mil) und CSP Anwendungen (>0.3mm dia.) für normales bis schnelles Drucken und einer langen Schablonenleerlaufzeit. Leistungsstarke Benetzung oxidierten Unterlagen und Komponenten wie z. B. oxidiertem Nickel. Ultimative Lösung für die Entnetzung.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2979	S3X48-M500C-5	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	3	ROLO	500 g	217° - 219°C
2980	S3X58-M500C-5	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	500 g	217° - 219°C

S3XNI58-M650-3 Bleifrei-Lotpaste für Automobil- und Industrienanwendungen

Anti-Riss-Legierung. Verbesserung gegenüber den mechanischen und thermischen Ermüdungserscheinungen von SAC-Legierungen. S3XI58 hat eine bessere Wärmewiderstandsfähigkeit und wirkt vorbeugend gegen das Auftreten von Whiskerwachstum. Verbesserte Haltbarkeit der Lötstellen durch Zugabe geringer Mengen an Indium und Nickel. Diese Legierung ist nicht nur für die Anwendung in der Automobilindustrie empfehlenswert, sondern auch für alle anderen industriellen Anwendungen, die eine sehr hohe Zuverlässigkeit erfordern. Halogenfrei. Geeignet für superschnelles Printing (>80mm/sec.). Herausragende Druckbarkeit von superfeinen Mustern (0.4mm pitch QFP, 0.5mm pitch CSP).

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2995	S3XNI58-M650-3	Sn95.95/Ag3.0/Cu0.5/Ni0.05/In0.5	4	ROLO	500 g	202° - 210°C

SB6N58-M500SI Bleifrei-Lotpaste mit mittlerem Schmelzpunkt

Bietet eine niedrigere Reflow-Temperatur als SnAgCu-Lotpasten. Das speziell entwickelte Flussmittel verhindert eine zu starke Reaktion mit der Lotlegierung und sorgt für eine stabile und konsistente Leistung. Perfekte Schmelz- und Benetzung durch Reflow in der Luft. Halogengehalt 0.2%.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2969	SB6N58-M500SI	Sn90/Ag3.5/Bi0.5/In6	4	ROLO	500 g	202° - 211°C

TB48-M742 Bleifrei-Lotpaste mit niedrigem Schmelzpunkt

Lotlegierung mit niedrigem Schmelzpunkt (138°C). Wird die SnAgCu-Legierung durch dieses Produkt mit niedrigem Schmelzpunkt ersetzt, lassen sich die CO₂-Emissionen um bis zu 40% reduzieren. Hervorragende Benetzung und low voiding. Halogenfrei (Br ≤ 900 ppm, Cl ≤ 900 ppm, Br + Cl ≤ 1500 ppm). Für Dosiersysteme ist TB48-M742D geeignet.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
2970	TB48-M742	Sn42/Bi58	3	ROLO	500 g	138°C

Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich

Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können Sie per Mail bei uns anfordern.

19.08.2015 is